

第4回 次世代電子実装システム技術講演会

9/1 木 15:00 - 16:50

定員 30名(来所)

100名(オンライン)

対象 当該テーマに関心のある方。
来所による参加で定員を超えた場合、
会員様優先になります。

多様化するMore than Moore の電子デバイスシステム集積技術に向けて、先端実装技術の産業分野への展開や次世代実装技術の産官学連携開発体制構築を目指した研究会を設立しました。次世代電子実装システム技術関連や研究会に関連する情報をご提供します。

対象: 研究会員 準研究会員 特別会員 聴講会員 非会員

15:00-15:05 オープニング 青柳 昌宏 卓越教授 国立大学法人熊本大学 大学院先端科学研究部 半導体研究教育センター

15:05-16:05 機械的応力に起因する半導体デバイスの電気特性変動現象



講師: 小金丸 正明 准教授

国立大学法人鹿児島大学 学術研究院
理工学域工学系

講演内容

半導体チップの大型化・薄型化により、実装時に半導体チップに生じる機械的応力(ひずみ・変形)が大きくなる傾向にある。この実装応力は、接合部のはく離など機械的損傷・破壊を生じさせる原因となる。また、機械的な損傷・破壊が生じなくても、チップに生じた機械的応力が半導体デバイスの電気特性を変動させることが知られている。機械的応力に起因する半導体デバイスの電気特性変動現象について、実装応力の評価手法と併せて概説する。

プロフィール

1994年福岡県入庁、工業技術センター機械電子研究所勤務。2016年鹿児島大学学術研究院准教授。電子実装の信頼性評価に関する研究に従事。

16:05-16:35 次世代電子実装技術に関連する近年の動向

講演内容

多様化するMore than Moore の電子デバイスシステム集積技術では半導体の高密度化を実現するため、薄化し、多層化した電子デバイスが目立っている。これら次世代電子実装技術の近年の動向と次世代実装技術の産官学連携開発体制構築を目指した研究会について紹介する。

根本 俊介

KISTEC 電子技術部 電子デバイスグループ

16:35-16:45 総合質疑

16:45-16:50 エンディング 三橋 雅彦 KISTEC 電子技術部

次世代実装システム技術研究会
<https://www.kistec.jp/nepstech/report/>

参加申し込みは、右隣記載のQRコードをクリック。
または、読み込んで頂きホームページからご登録ください。
申込締め切りは8/30。
ご不明な方はお問い合わせにご連絡ください。



お問い合わせ: 電子技術部 電子デバイスグループ 根本俊介 E-mail: sm-electronic_devices_g@kistec.jp

主催: 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)